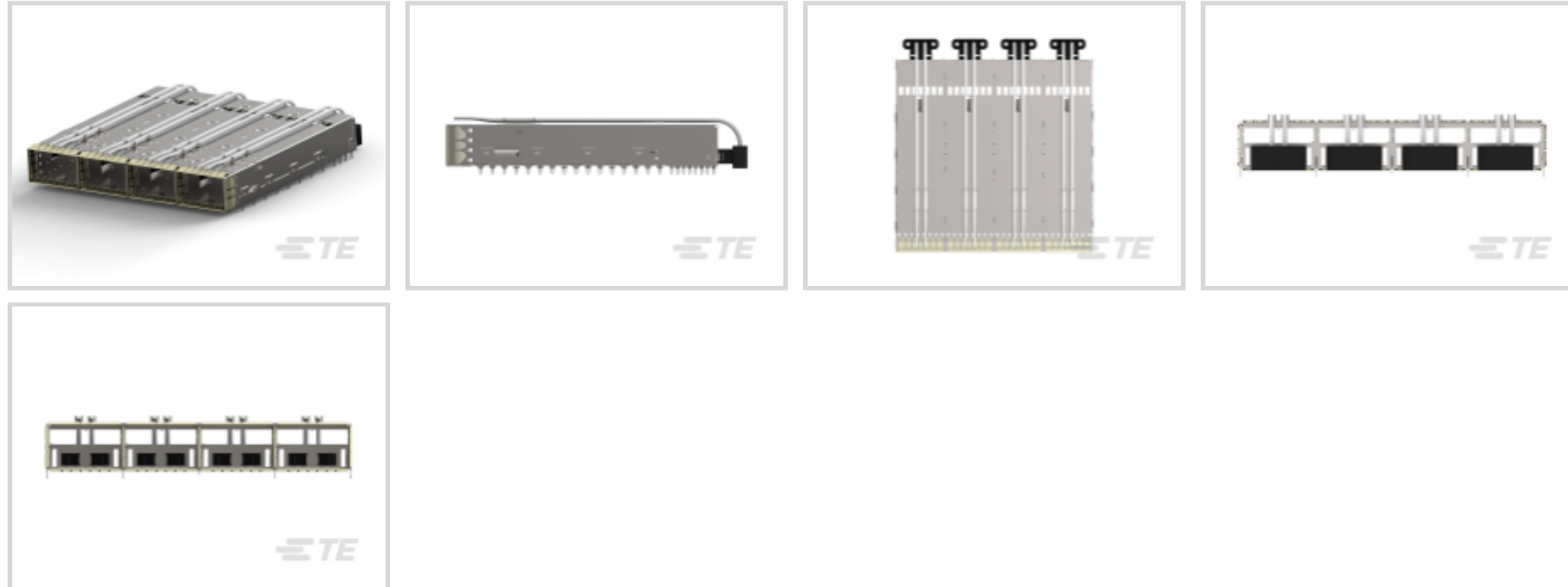




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > OSFP 壳体组件：EMI 弹片



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

工作温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

位数: 240

端口数量: 4

[所有 OSFP 壳体组件：EMI 弹片 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|--------------|------|
| 笼子类型 | 联动 |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 壳体组件 |
| 可密封 | 否 |
| 外形尺寸 | OSFP |

结构特性

| | |
|--------|-------|
| 位数 | 240 |
| 端口数量 | 4 |
| 端口矩阵配置 | 1 x 4 |

使用环境

| | |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

其他

| | |
|------------|--------------|
| 包括的光管 | 是 |
| EMI 遏制特性类型 | 内部/外部 EMI 簧片 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2338495-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2338495-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2338495-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[OSFP Cages, Connectors, and Cable Assemblies \(English\)](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本